



台積公司頒發2021年度開放創新平台合作夥伴獎項

生態系統夥伴榮獲2021年OIP獎項以表揚其半導體創新之合作與貢獻

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2021年10月27日

台灣積體電路製造股份有限公司今（27）日頒發 2021 年度開放創新平台（Open Innovation Platform[®], OIP）合作夥伴獎項，感謝 11 家電子設計自動化、矽智財、以及雲端聯盟合作夥伴的傑出貢獻與支持。台積公司年度 OIP 合作夥伴獎項表彰過去一年來 OIP 生態系統夥伴在實現下一代設計方面追求卓越的貢獻，藉由齊力合作與努力，有效推動半導體產業的創新。台積公司於 2021 年開放創新平台論壇宣布得獎夥伴，此年度盛會集結了半導體設計生態夥伴與台積公司客戶，提供最佳的平台來討論最新的技術與設計解決方案，支援高效能運算、智慧型手機、車用電子、以及物聯網應用。

台積公司設計暨技術平台副總經理及台積科技院士魯立忠博士表示：「透過產業最全面、完備且生氣蓬勃的設計生態系統，台積公司與開放創新平台夥伴通力合作，協助客戶設計下一代晶片，並且達到最佳結果。恭喜台積公司年度 OIP 合作夥伴獎的所有得獎者，各位合作夥伴的持續合作與努力讓我們的技術發展能夠維持領先，同時協助客戶充分利用台積公司先進技術於功耗、效能、面積方面大幅提升的優勢，加速產品差異化的創新。」

台積公司於 2008 年創建了開放創新平台，匯集客戶與夥伴的創新思考，降低設計門檻，為半導體設計產業帶來最具時效的創新。台積公司重視每一位生態系統合作夥伴，與其攜手提供採用台積公司最新技術並通過認證之解決方案與服務，以實現下一代設計。榮獲 OIP 年度合作夥伴獎項的公司在設計、開發、以及技術實作方面皆達到最高的標準。

台積公司 2021 年度 OIP 合作夥伴得獎名單如下：

矽智財聯盟得獎夥伴

- 類比與混合訊號矽智財：Silicon Creations
- DSP 矽智財：益華電腦
- 嵌入式記憶體矽智財：eMemory Technology Inc.
- 新興矽智財公司：proteanTecs Ltd.
- 高速 SerDes 矽智財：Alphawave IP
- 介面矽智財：新思科技
- 處理器矽智財：安謀國際
- 特殊製程矽智財：M31 Technology



電子設計自動化聯盟得獎夥伴

- 共同開發 4 奈米設計架構
 - ANSYS
 - 益華電腦
 - Siemens EDA
 - 新思科技
- 共同開發 3DFabric™ 設計生產解決方案
 - ANSYS
 - 益華電腦
 - Siemens EDA
 - 新思科技

雲端聯盟得獎夥伴

- 共同開發雲端生產解決方案
 - 益華電腦
 - 微軟
 - Siemens EDA

關於台積公司開放創新平台 (OIP)

台積公司開放創新平台 (OIP) 匯集客戶與夥伴的創新思考，秉持縮短設計時間、縮短量產時程、加速產品上市時間並加快獲利時程之共同目標。開放創新平台涵蓋半導體產業最完備的設計生態系統聯盟，集結包括業界領先的電子設計自動化、資料庫、矽智財、雲端、以及設計服務夥伴。台積公司自從成立以來即與設計夥伴及客戶緊密合作，並持續將矽智財與資料庫組合擴增至超過 4 萬個項目。目前能夠為客戶提供自 0.5 微米至 3 奈米超過 3 萬 8,000 個技術檔案及超過 2,600 個製程設計套件。

關於台積公司

台積公司成立於1987年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2020年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等281種製程技術，為510個客戶生產1萬1,617種不同產品。台積公司為世界首家提供5奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站<https://www.tsmc.com.tw>查詢。



#

台積公司發言人：
黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：
高孟華
企業公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 7125036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

孔培德
企業公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 7125031
Mobile: 0988-931-352
E-Mail: pdkramer@tsmc.com